

第7回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 26 年 9 月 3 日(水) 10:30~16:30

場所:大阪大学吹田キャンパス 岡田メモリアルホール (大阪府吹田市)

時 間	題 目	講 演 者
	司会 (群馬大学 井上 雅博)	
10:30~ 12:00	『液晶構造の導入による高熱伝導性エポキシ樹脂の開発』 (45分)	関西大学 ○ 原田 美由紀
	『Au レス最終表面処理の実装性について』 (45分)	奥野製薬工業(株) ○ 田邊 靖博
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	委 員 会 議 事	
	司会 (化研テック(株) 鎌田 信雄)	
13:10~ 14:30	『焼結フリー金属ナノインクによるプリントド・エレクトロニクス』 (40分)	岡山大学 ○金原 正幸
	『自己伝播発熱素材を用いた瞬間ハンダ接合技術の有用性』 (40分)	兵庫県立大学 ○生津 資大
	休憩(15分)	
	司会 (オムロン(株) 阪元 智朗)	
14:45~ 16:30	『最新実装技術と材料について』 (40分)	千住金属工業(株) ○日渡 逸人
	『静電気を利用した成膜・塗布工法に関して』 (40分)	アピックヤマダ(株) ○小林 一彦
	『低温・短T A T実装のニーズに応える接着剤接合技術』 (25分)	富士通クオリティ・ラボ(株) ○伊達 仁昭

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。